



专业12英寸自动探针台T-3000

用于12"、8"、6"、4"、2"的整晶圆测试；或矩形区域内芯片测试；

进行I-V、C-V、光信号、RF射频、1/f噪声特性分析，大功率晶圆测试等；

兼容丰富仪表：数字源表、网分、半导体参数分析仪、高压测试仪等；

可加装高级的硬件通信与测试平台软件，轻松集成所需的仪器仪表。

可加载温控系统，满足在特定环境下的特性参数测试。

用于实验室芯片验证，研究、产线上批量芯片测试等。

上一个

返回

下一个

规格参数:

PDF手册下载
 综合资料下载

产品概要:

这是一款12英寸专业自动测试探针台；集成了电学测量、光波测量、微波测量等众多功能；可用于多种测试应用环境；与对应的测试仪连接后，能自动完成对各种晶圆、芯片的电参数测试；可应用在负载牵引、RF、mmW、硅光子学、设计验证中；操作简单，快捷，测试精度高。具有MAP显示功能；是应对各类芯片性能测试的综合型高效半自动晶圆探针台。

应用方向:

用于12"、8"、6"、4"、2"的晶圆测试；或矩形PCB，矩形区域内芯片测试；进行I-V、C-V、光信号、RF射频、1/f噪声特性分析，大功率信号测试等；

设备概览:

显微镜单元

- 倍率：30X-150X（支持升级）
- 可变倍率：0.7~4.5 倍率
- 标配 LED 环形光源
- 调焦支持粗调和细调
- 调节焦距范围：0~30mm

显微镜位移台

- 可 X/Y 平面位移，范围>60MM*60MM
- Z 轴可精细调节，0~30MM
- 采用精密丝杆和导轨，线性位移

载物台单元 (CHUCK)

- 独立控制真空吸附功能(标配)
- 合金材质，可选镀金或镀镍
- 可定制尺寸，吸附孔位置等
- 可升级为加热载物台
- 可±5 度微调角度

安全转矩关断功能

- 确保人身或机械设备安全
- 不用完全断电情况下停止机械移动

高强度基座

- 加厚加宽设计
- 刚性更好，更加稳固

高清工业相机

- 可将画面通过高清彩色大屏幕显示
- 支持一键拍照，录像功能
- 支持带十字线显示和测量功能

软件界面终端

- 包含丰富的参数设定界面
- 大区域显示晶圆 MAP 图
- 高清显示芯片扎针画面
- 测试芯片信息实时显示

精密探针座

- 高级磁性开关底座，可选真空吸附型
- 底座前端可 0~30° 倾斜，精细调节
- 可升级为射频探针座，进行射频测试
- 四轴调节，配微分头精密调节位移
- 兼容主流探针夹具

探针台面

- 台面加宽设计，双层合金材质
- 同时可放置多达 6~8 个常规探针底座
- 台面精细电镀处理，光洁抗锈蚀

综合控制系统

- 内置高性能控制器
- 采用内循环降温设计，保障稳定运行
- 支持连接多路外部仪器，支持 USB、GPIB
- 支持 TCP/IP 通信等

规格参数:

分类	名称	型号
晶圆测试硬件选项	12英寸自动探针台	T-3000
	Chuch卡盘尺寸	12英寸；外径305mm（标配）
	Chuch卡盘固定晶圆方式	负压（真空）吸附、吸附孔搭配吸附槽（气阀独立开/关控制）（标配）
	电子显微镜系统	高清放大150X（支持升级）
	探针座	MP-150*2（标配）（选配：MP-180、MP-200。。。）
	探针夹具	2副同轴探针夹具（标配）
	DC探针	1微米/2微米/5微米/10微米/20微米/50微米/100微米/200微米（选配）
	接口类型	同轴Triaxial，SMA,BNC,RF接口可选
	射频测试频率范围	dc~26.5GHz/40GHz/50GHz/67GHz/110GHz（选配）
	高清成像系统	高清1080P工业相机*1、高清显示器*2（标配）
自动运行硬件参数	无油真空泵	1台（标配）（提供晶圆吸附作用）
	工控机系统环境	Windows 10
	兼容晶圆尺寸	支持标准1、2、4、5、6、8、12英寸晶圆；或矩形区域内芯片测试；
	兼容晶圆厚度	最大5000 um
	X轴行程	≥310mm
	X轴分辨率	0.1μm
	Y轴行程	≥310mm
	Y轴分辨率	0.1μm
	X/Y轴重复定位精度	≤±3μm
	Z轴结构	双Z轴，两套全闭环光栅系统
	Z轴行程	≥10mm
	Z轴分辨率	0.1μm
	Z轴重复定位精度	≤±3μm
	Z轴下降保护	自保持恒定
	θ轴旋转调节范围	≥±5 Deg
	θ轴驱动方式	电机+精密丝杆+转盘
	θ轴掉电自保持	掉电（当前位置）自保持
	θ轴调节方式	选点校准角度+精细微调
自动运行软件终端	X/Y/Z驱动方式	伺服马达+滚珠丝杆+光栅尺（全闭环控制）
	X/Y/Z参考原点复位精度	1LSB（0.1um）
	测试模式	晶圆模式、矩形模式（可一键切换测试类型）
	测试MAP图	晶圆模式MAP、矩形模式MAP
	芯片状态分类	待测、不测、已测合格、已测不合格
	芯片选择功能	纳入待测，或者不测
	MAP中芯片定位方式（3种）	双击芯片移动
		指定芯片序号移动
		上一颗/下一颗移动
	任意芯片测试	可任意指定测试起/止
	丰富晶圆参数设置	芯片长、宽/芯片切割道设置/晶圆边沿留空/晶圆尺寸大小设置/晶圆整体偏移设置等
	单料芯片测试时长	可任意设置，默认1秒
	晶圆参数加载/保存	具备
	尺寸测量功能	具备
	测试时微抬针高度设置	具备，可设置
	停机时探针复位高度	默认5mm，可设置
	当前测试芯片信息显示	具备
	测试后数据自动保存	具备
	图像判断功能	(选配)
	图像引导定位功能	(选配)
	打墨点功能	(选配)
运行环境要求	设备供电	AC220V，3500W(Max)，50Hz
	设备占用空间	(长*宽*高) 1.2米*1.2米*1.5米
	设备重量	约600KG（配置不同而存在差异）
	环境温度	恒温（24℃至30℃）
	环境湿度	≤ 50% RH
(可代开发联控第三方仪器软件)		
以上参数仅供参考，购买以实际订购的配置参数为准！		

关于成都测芯科技有限公司

成都测芯科技有限公司是一家专注于微电子测试的先进探针台生产厂家！产品包括科研型 4 寸、6 寸、8 寸、12 寸探针台、高温探针台、高低温非真空探针台、高低温高真空探针台、（超）低温探针台、RF / mmW 毫米波探针台、高压探针台、磁场探针台、光电探针台、镭射系统探针台、气敏探针台等。公司产品由优秀的研发团队精心设计。注重每一个功能的完美实现，帮助用户实现可靠、高效、精确的电子参数测试！

成都测芯科技有限公司期待与您的真诚合作！

Chengdu Chiptest Technology Co., Ltd.

成都测芯-对外测试服务点



成都测芯-先进制造中心

Advanced Manufacturing Center

地址：四川成都高新区（西区）西芯大道 12 号

邮编：611731



网站：WWW.CHIPTEST-TECH.COM

地址：四川省成都市高新区（西区）西芯大道 12 号

座机：028-6414 7663

邮箱：info@chiptest-tech.com

邮编：611731